

2021-2027年中国驱动IC 用COF产业发展现状与未来前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国驱动IC用COF产业发展现状与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202011/193418.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

COF，将驱动IC固定于柔性线路板上晶粒软膜构装技术，是运用软质附加电路板作封装芯片载体将芯片与软性基板电路接合的技术。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国驱动IC用COF产业发展现状与未来前景预测报告》共八章。首先介绍了驱动IC用COF相关概念及发展环境，接着分析了中国驱动IC用COF规模及消费需求，然后对中国驱动IC用COF市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国驱动IC用COF面临的机遇及发展前景。您若想对中国驱动IC用COF有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 COF产品概述

第一节 COF的定义

第二节 COF品种

第三节 COF——目前的主流挠性IC封装形式

一、IC封装

二、IC封装基板与常规印制电路板在性能、功能上的差异

三、IC封装基板的种类

第四节 COF与TAB、TCP、TAPE BGA/CSP在定义上的区别

第五节 COF在驱动IC中的应用

第六节 COF行业与市场发展概述

第二章 COF的结构及其特性

第一节 COF的结构特点

第二节 COF在LCD驱动IC应用中的特性

第三节 COF与其它IC驱动IC封装形式的应用特性对比

一、COF与COG比较

二、COF与TAB比较

第四节 未来COF在结构及其特性上的发展前景

一、制作线宽/线距小于 $30\mu\text{m}$ 的精细线路封装基板

二、卷式（ROLL TO ROLL）生产方式的发展

三、多芯片组装（MCM）形式的COF

第五节 COF的更高阶封装形式——基于挠性基板的3D封装的发展

一、从2D发展到3D的挠性基板封装

二、基于挠性基板的3D封装的主要形式

第三章驱动IC产业现状与发展

第一节 驱动IC的功能与结构

一、驱动IC的功能及与COF的关系

1、驱动IC的功能

2、驱动IC与COF的关系

二、驱动IC的结构

三、驱动IC的品种

第二节 驱动IC在发展LCD中具有重要的地位

第三节 大尺寸TFT-LCD驱动及其特点

一、大尺寸TFT-LCD驱动特点

二、大尺寸TFT-LCD驱动芯片设计难点

第四节 驱动IC产业的特点

第五节 世界显示驱动IC的市场现况

一、显示驱动IC制造厂商与下游LCD面板厂家的关系及分析

二、世界显示驱动IC设计业现况

三、世界显示驱动IC市场规模调查统计

第六节 世界显示驱动IC主要生产厂家的现况

第四章液晶面板应用市场现状与发展

第一节 世界液晶面板市场规模与生产情况概述

一、世界液晶面板市场变化

二、世界面板市场品种的格局

三、台、中、日、韩面板产业发展及趋势分析

第二节 世界大尺寸TFT-LCD应用市场发展现况

- 一、世界大尺寸面板市场规模总述
- 二、液晶电视领域对大尺寸面板的需求情况
- 三、平板电脑领域对大尺寸面板的需求情况
- 四、显示器领域对大尺寸面板的需求情况
- 五、对2019年世界大尺寸面板市场需求的预测
- 第三节 我国液晶面板市场规模与生产情况概述
- 一、我国驱动IC设计行业的情况
- 二、我国液晶面板产业的发展
- 三、我国液晶面板生产现况与未来几年发展预测

第五章 COF的生产工艺及技术的发展

第一节 COF制造技术总述

- 一、COF的问世
- 二、COF的技术构成

第二节 COF挠性基板的生产工艺技术

- 一、COF挠性基板生产的工艺过程总述及工艺特点
- 二、挠性基板材料的选择
- 三、精细线路的制作

第三节 IC芯片的安装技术

第四节 COF挠性基板的主要性能指标

第六章 世界COF基板的生产现状

第一节 全世界COF基板生产量统计

第二节 全世界COF市场格局

第三节 全世界COF基板主要生产厂家

第四节 全世界COF基板主要生产情况

- 一、日本COF基板厂家
- 二、韩国COF基板厂家
- 1、韩国LG MICRON
- 2、韩国STEMCO
- 三、台湾COF基板厂家
- 1、台湾欣邦

2、台湾易华

第七章我国COF基板的生产现状

第一节 我国FPC业的现状

第二节 我国COF的生产现况

第三节 我国COF基板的生产企业现况

一、国内COF基板生产企业发展概述

二、深圳丹邦科技股份有限公司

1、企业概况

2、COF相关产业发展概况

3、企业经营情况

4、核心优势及发展战略

三、三德冠精密电路科技有限公司

1、企业概况

2、COF相关产业发展概况

3、企业经营情况

4、核心优势及发展战略

四、上达电子（深圳）股份有限公司

1、企业概况

2、COF产业发展概况

3、企业经营情况

4、核心优势及发展战略

五、厦门弘信电子科技股份有限公司

1、企业概况

2、COF产业发展概况

3、企业经营情况

4、核心优势及发展战略

第八章 COF挠性基板用二层型挠性覆铜板特性与生产现状

第一节 二层型挠性覆铜板品种及特性

第二节 挠性覆铜板产品主要采用的标准及性能要求

一、适用于FCCL的中国国家标准介绍

二、国际上广泛使用的FCCL标准介绍

- 1、IPC标准
- 2、IEC标准
- 3、日本标准
- 4、测试方法比较

三、实际产品应用中的性能要求

第三节 挠性覆铜板的生产工艺

一、三层型挠性覆铜板的生产工艺

- 1、片状制造法
- 2、卷状制造法

二、二层型挠性覆铜板的生产工艺

- 1、涂布法（CASTING）
- 2、层压法（LAMINATION）
- 3、溅镀法（SPUTTERING/PLATING）

第四节 世界挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

- 一、总述
- 二、日本FCCL业生产现状与发展
- 三、美国、欧洲FCCL业的现状与发展
- 四、台湾FCCL业的现状与发展
- 五、韩国FCCL业的现状与发展

第五节 我国国内挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

- 一、我国国内挠性覆铜板业发展总述
- 二、我国国内挠性覆铜板生产厂家现况

图表目录：

图表1：三种封装基板的CTE及对CCL的CTE要求

图表2：COF与COG比较分析

图表3：COF与TAB比较分析

图表4：2015-2019年世界显示驱动IC市场规模调查统计

图表5：世界显示驱动IC主要生产厂家的分析

图表6：2015-2019年全球主流面板厂商分区域销售额走势（单位：十亿美元）

图表7：2015-2019年全球大尺寸面板出货数量及同比走势（单位：百万台，%）

图表 8：2015-2019年全球大尺寸面板分应用平均尺寸走势（单位：英寸）

图表 9：2021-2027年全球液晶电视面板平均尺寸走势（单位：英寸）

图表 10：2021-2027年全球液晶电视面板分分辨率占比走势（%）

图表 11：2021-2027年全球分世代线面板产能（ $\geq$ G7）走势（ Km^2 ，%）

图表 12：2021-2027年全球智能手机用AMOLED产能增长趋势（刚性+柔性）

图表 13：全球AMOLED和LCD智能手机面板渗透率走势图（2021-2027年）

图表 14：四地面板企业数量变化图

图表 15：2015-2019年全球液晶面板出货量市占率走势

图表 16：2018全球电视面板出货量（百万片）

图表 17：四地液晶面板产能统计及预测（亿平方米）

图表 18：大陆OLED产能建设情况

图表 19：日韩台厂OLED产能建设情况

图表 20：2015-2019年全球大尺寸面板出货量统计分析

图表 21：2015-2019年全球大尺寸面板出货量

图表 22：2015-2019年液晶电视领域大尺寸面板需求量分析

图表 23：2015-2019年全球平板电脑领域对大尺寸面板需求量分析

图表 24：2015-2019年显示器领域对大尺寸面板需求量分析

图表 25：中国崛起为全球LCD产业第三极

图表 26：COF封装技术工艺流程

图表 27：2015-2019年全球COF基板产量统计分析

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202011/193418.html>